



2025年3月期 決算説明資料

東証スタンダード 証券コード：6614
2025年5月13日

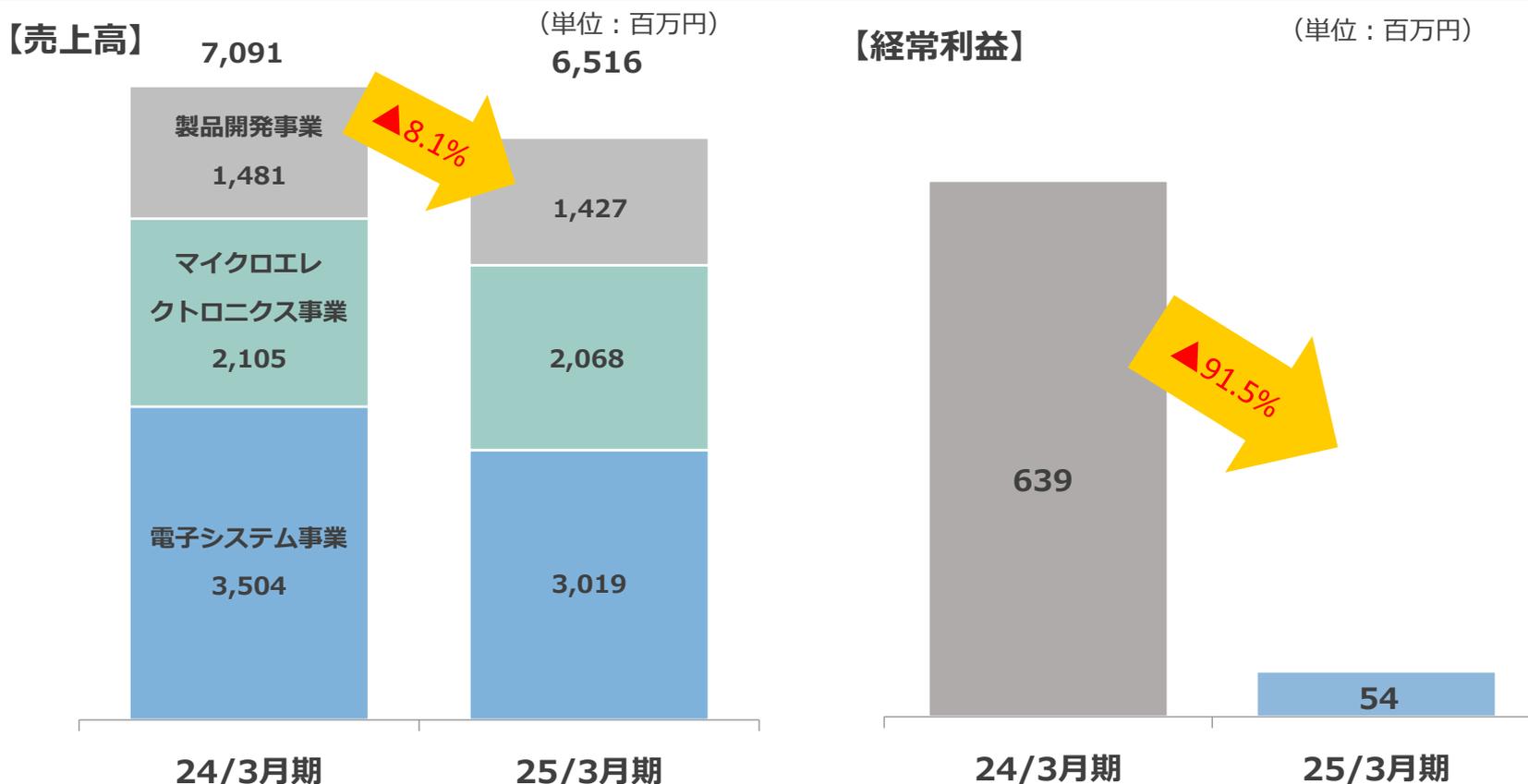
2024年度（2025年3月期）は減収・減益

- 電子システム事業の売上の落ち込みが大きく、通期予想比及び前年比ともに低調な結果となる。マイクロエレクトロニクス事業及び製品開発事業は前年比僅かながら減収となるも堅調に推移。
- 利益は、修正予想比では売上未達による影響を受け大きくマイナス、前年比では減収による影響に加え、人員増及びベアによる労務費増加や新基幹システム稼働による償却費発生、前年は4Qのみの発生であった福島事業所の年度を通じた経費発生等によりコストが大きく増加し、営業利益・経常利益ともに大幅減益。

(単位：百万円)

	2025/3月期 通期予想 (11月11日修正)	2025/3月期 通期予想 (4月18日修正)	2025/3月期 通期実績	通期予想 達成率 11/11予想対比	2024/3月期 通期実績	対前年 増減率
売上高	6,715	6,516	6,516	▲3.0%	7,091	▲8.1%
営業利益	155	56	56	▲63.7%	604	▲90.7%
経常利益	150	54	54	▲63.7%	639	▲91.5%
当期純利益	130	▲7	▲14	-	509	-

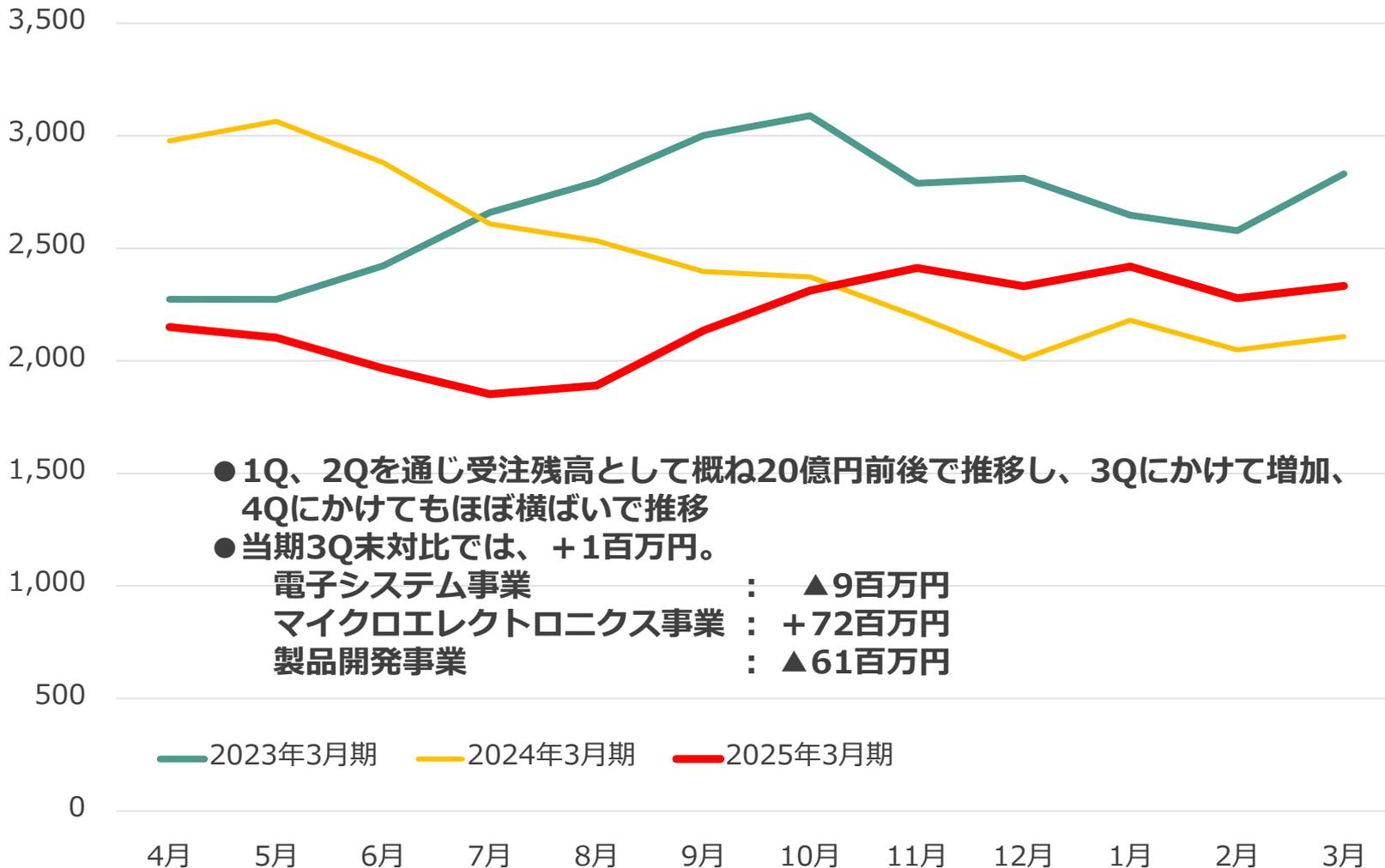
- ・ 車載用半導体の市場在庫充足による生産調整局面が継続し、また一部顧客においてバーンインレス化が進んだこともありバーンインボードを中心とする半導体後工程商材の受注が大きく減少、加えて、福島事業所における既存顧客製品の受注が市況の低迷により想定以上に減少したことから、電子システム事業が大幅減収。
- ・ マイクロエレクトロニクス事業及び製品開発事業は前年比僅かながら減収となるも堅調に推移。



※売上高・経常利益は前期比で減収・減益。

【受注残高（全社）】

（単位：百万円）



● 1Q、2Qを通じ受注残高として概ね20億円前後で推移し、3Qにかけて増加、4Qにかけてもほぼ横ばいで推移

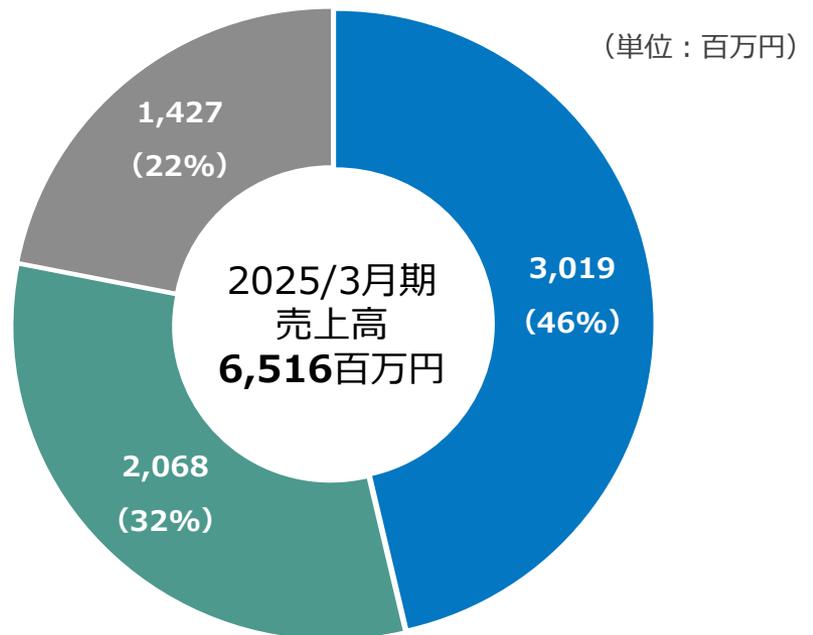
● 当期3Q末対比では、+1百万円。

電子システム事業 : ▲9百万円

マイクロエレクトロニクス事業 : +72百万円

製品開発事業 : ▲61百万円

— 2023年3月期 — 2024年3月期 — 2025年3月期



25/3月期売上構成

電子システム事業

半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、高速通信機器、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、電子機器の開発・設計・製造

マイクロエレクトロニクス事業

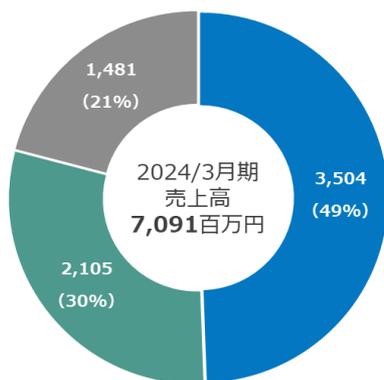
LSI設計（アナログ・デジタル）、IPコア

電源IC設計、高速I/F設計、イメージセンサ設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計、技術者派遣、JPEG、MIPI、ISP

製品開発事業

組み込みカメラモジュール・画像システム

画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール



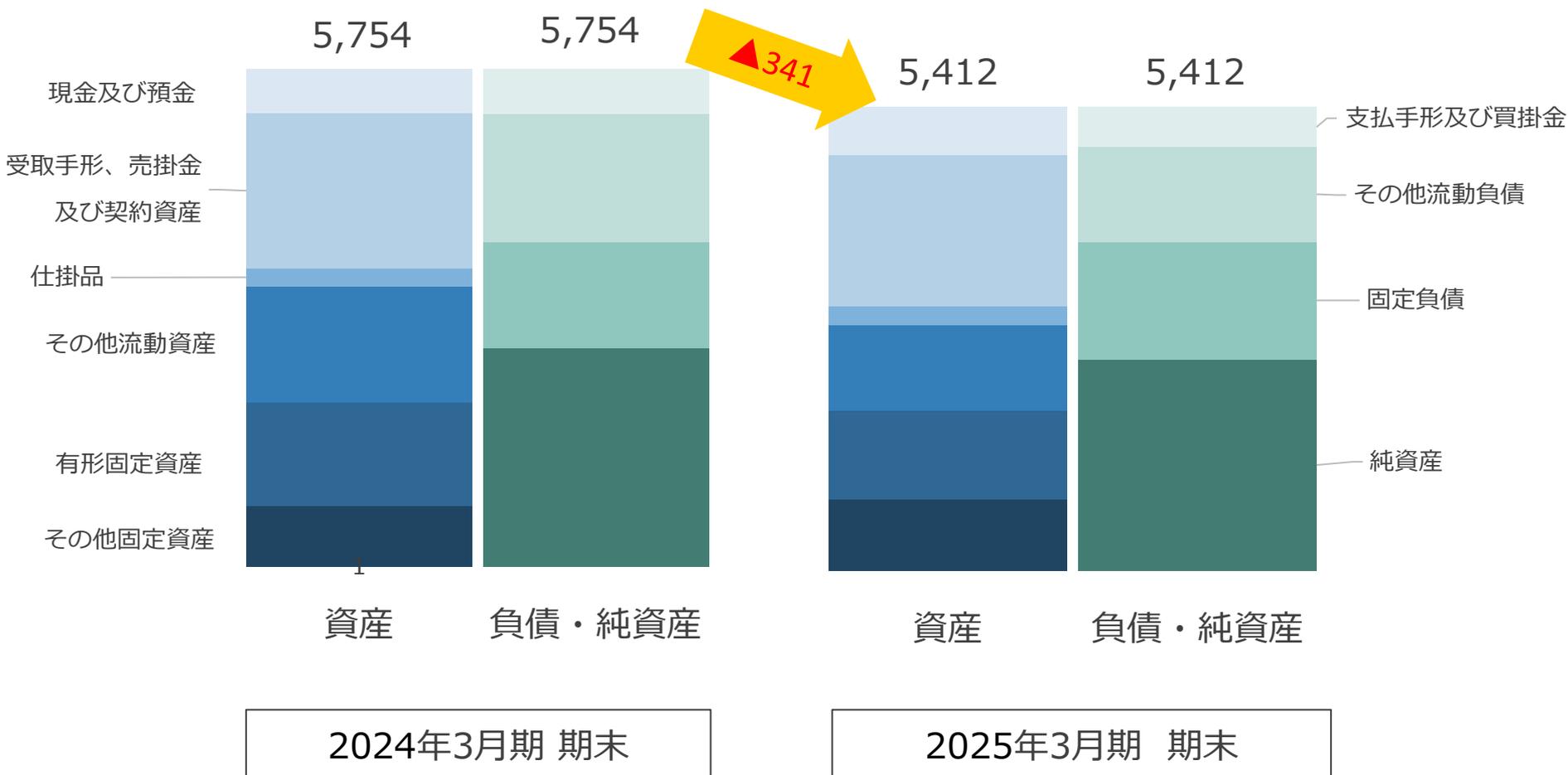
(参考) 24/3月期売上構成

【流動資産】 売上債権132百万円減少、棚卸資産153百万円減少。

【流動負債】 仕入債務48百万円、未払法人税等80百万円、賞与引当金48百万円、各々減少。

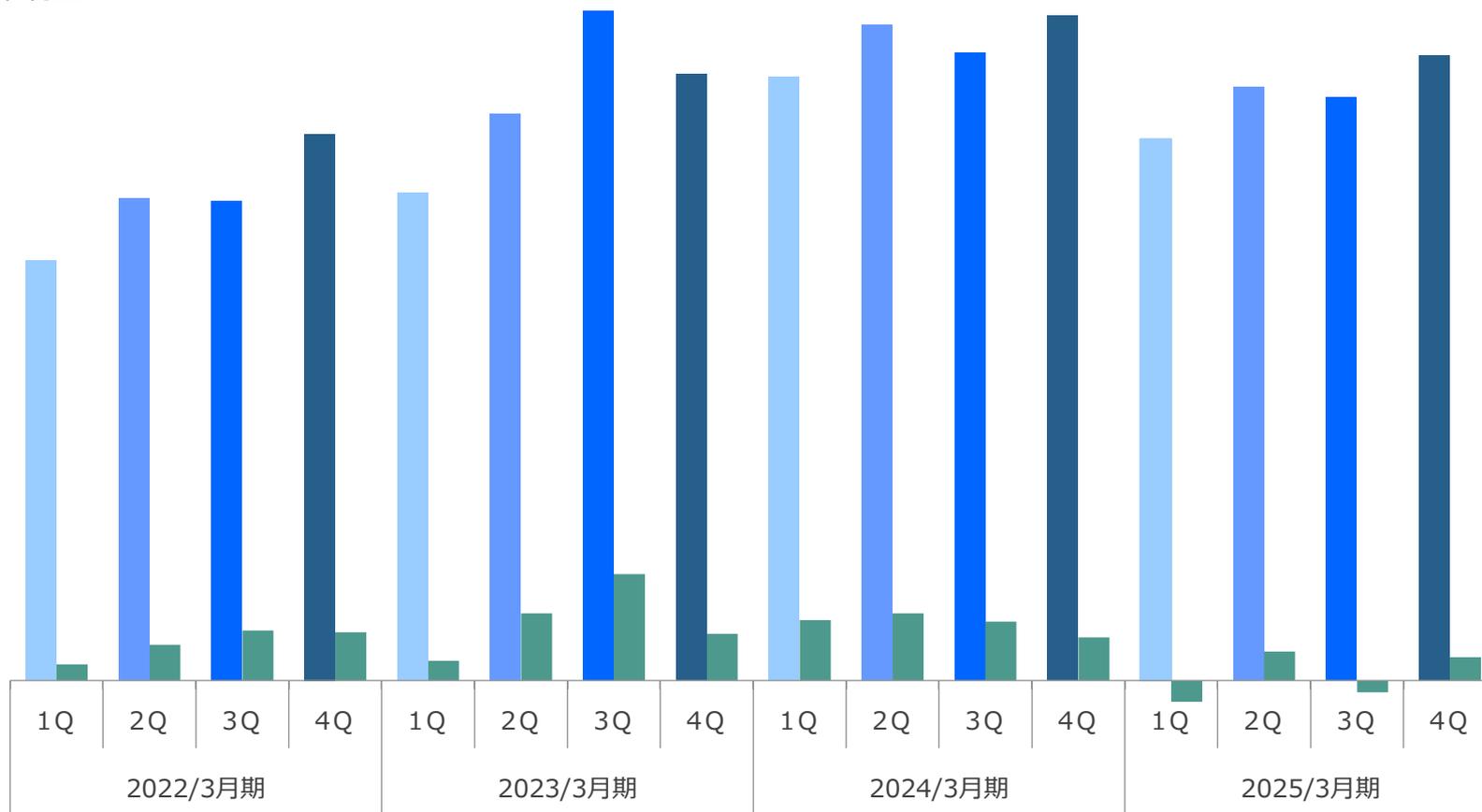
【純資産】 利益剰余金減少により純資産77百万円減少。自己資本比率45.7% (+1.4pt)。

(単位：百万円)



2024年	4月 12日	当社技術に関する記事掲載（無人探査機「SLIM（スリム）」に、当社画像処理技術が搭載）	1Q	
	5月 14日	決算発表・剰余金の配当		
	5月 29日	太陽光発電による再生可能エネルギー（オフサイトPPA）の採用		
	6月 12日	決算説明会 神奈川県横浜市中区に神奈川事業所を設置・事業開始		
	6月 19日	ルネサスエレクトロニクスのプリファード・パートナーに参画		
	6月 25日	第52期 定時株主総会 とやま介護テクノロジー普及・推進センターにて、センサー+カメラ一体型見守りシステム「C-エイド」常設展示開始		
	7月29日	ルネサスIPライセンスパートナーに加入		
	8月23日	宇宙航空研究開発機構（JAXA）様より感謝状を受領		2Q
	8月28日	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社様より「Contribution Award」を受賞		
	8月29日	個人投資家向け会社説明会		
2024年	10月16日	くまもと3D連携コンソーシアムに入会のお知らせ	3Q	
	11月6日	半導体検査装置の海外向け製品の販売を開始		
	12月6日	上期決算説明会		
2025年	3月12日	シキノハイテックとCASTが提携し、シリコンIPの市場拡大を図る	4Q	
	4月18日	通期業績予想の修正に関するお知らせ	1Q	
	4月18日	新製品 介護施設向けミリ波レーダー・カメラ一体型見守りシステム C-エイド～2025年4月より注文受付開始～		
	4月24日	台湾半導体市場への拡販に向け AGNEZ TECH INC.と協業開始		
	4月28日	パナソニック ホールディングス株式会社とライセンス契約を締結し Nessum (IEE E 1901-2020準拠) 通信モジュールを開発		

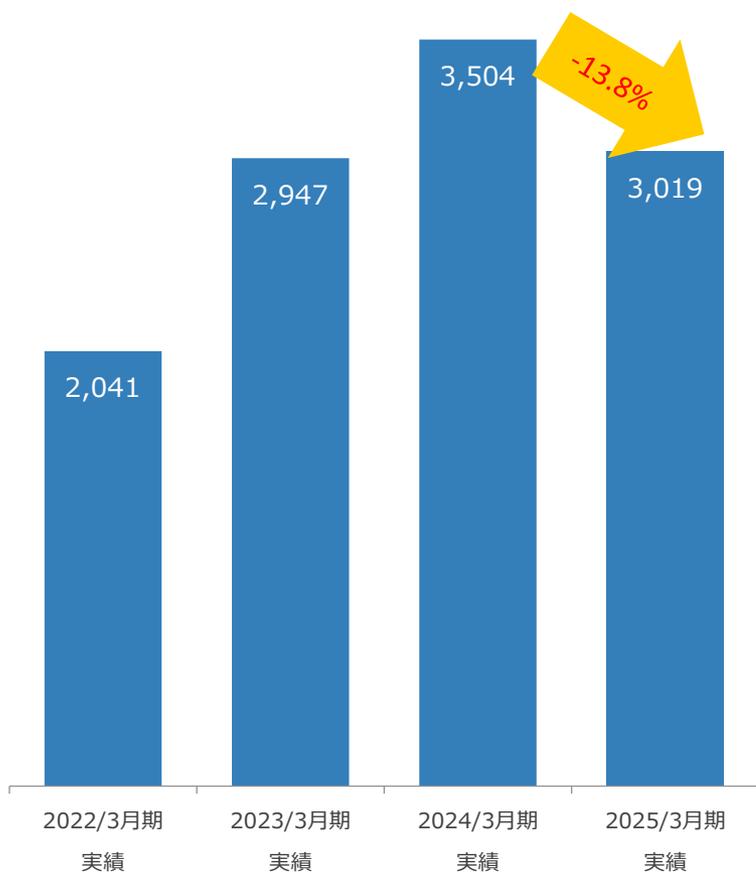
■ 1Q売上高
 ■ 2Q売上高
 ■ 3Q売上高
 ■ 4Q売上高
■ 経常利益



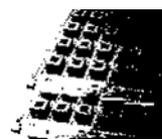
車載半導体は市場在庫調整による各社生産調整強化継続中、試験方法変更で顧客設備投資が急減。
 パワー半導体・センサー向けのカスタムバーンイン装置は、前年の生産設備拡充完了で所要大幅減。
 車載用専用計測機器は計測器仕様、仕向け変更で周辺機器減少及び発注時期後ろ倒しで受注額減。

【売上高】

(単位：百万円)



2024年度トピックス



バーンインボード
 前年比：78%



半導体検査装置販売・リース
 前年比：36%



車載製品用専用計測機器関連
 前年比：85%

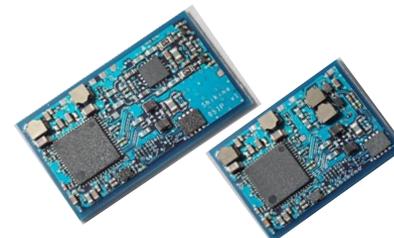
神奈川事業所開所

営業 + 開発拠点の稼働開始



Nessum 4G

nessum (IoT-PLC) 第4世代
 モジュールを開発



アナログは自動車向けパワー半導体設計が順調、センサー用半導体の設計はスマホ向けが堅調。デジタルはDSC画像処理関連の設計が減少、自動車向けへのシフトを進めるも市況悪化。

【売上高】

(単位：百万円)



2024年度トピックス

➤ アナログ半導体設計受託

自動車向け等パワー半導体
前年比：150%



センサー用半導体
前年比：70%



➤ デジタル半導体設計受託

DSC等画像処理関連
前年比：65%



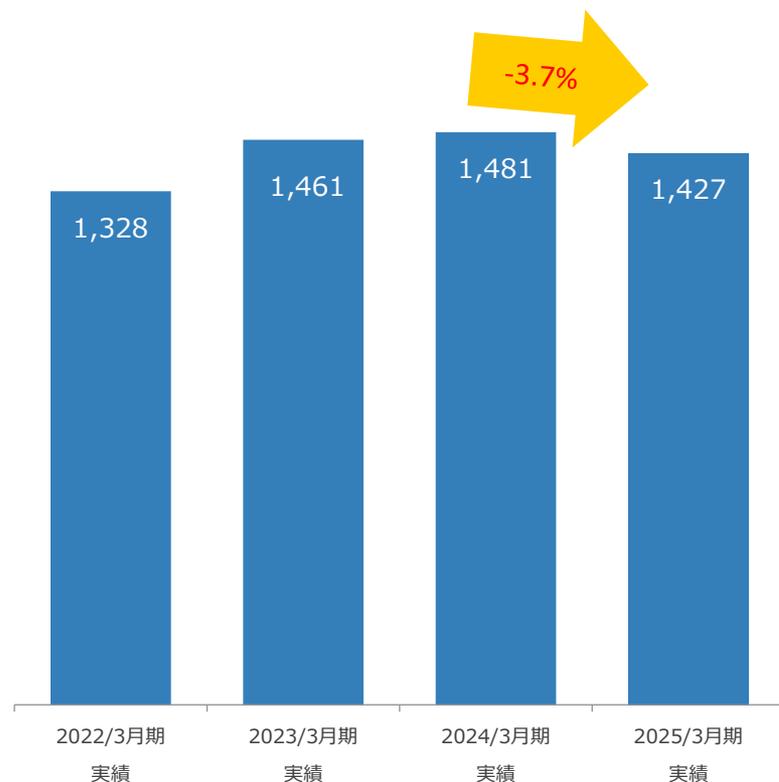
自動車関連デジタル設計
前年比：79%



医療検体検査装置、エレベーターや列車内監視カメラ製品の増加や受託の活動強化も国内ATMやセルフレジの所要減、半導体装置向け計画未達、新製品立ち上げ遅延により販売計画未達。

【売上高】

(単位：百万円)



24年度 トピックス

新商品の開発を完了

① 150M画素GS MIPI I/F

② 200M画素LANカメラ

③ 介護見守りシステム (商品名:C-エイド)

医療機器 第三種製造販売業の許可交付取得



□ 生産台数が累計200万台を達成

□ 国内外の展示会に出展

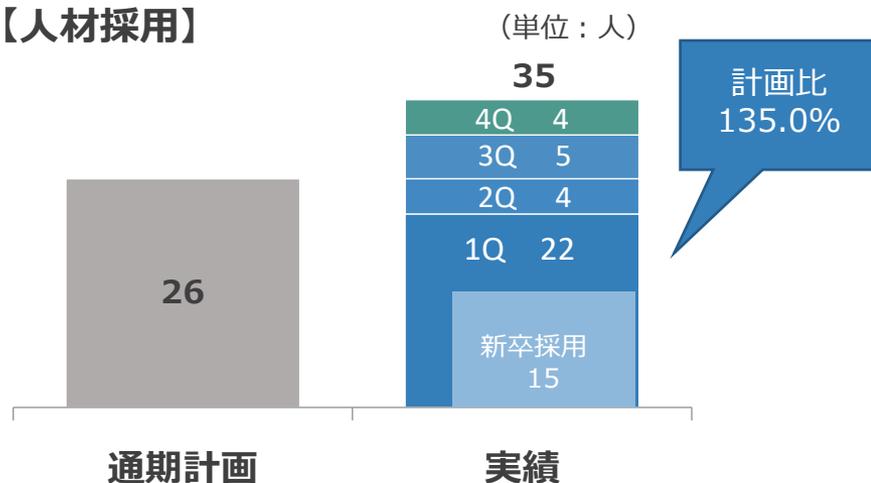
・electronica、embedded world(ドイツ)

・Edge+Tech、国際画像機器展(日本)

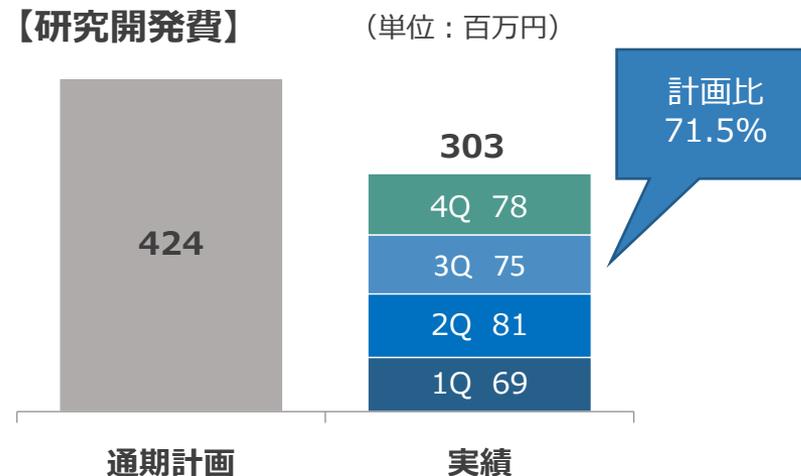


人材採用はキャリア採用の人材争奪戦の激化が継続するも計画を超えた実績を達成。
研究開発費は直近の販売に結び付く重要テーマに案件絞ったことにより計画未達。

【人材採用】



【研究開発費】



主要開発テーマ

電子システム事業

- ・半導体検査装置・カスタム検査装置
nessum4G/3G(IoT-PLC)通信モジュール

マイクロエレクトロニクス事業

- ・次世代JPEG IPコア
- ・通信用アナログデバイス

製品開発事業

- ・介護向けシステム、センシングカメラ・Viewカメラ後継機

2025年度（2026年3月期）は増収増益

- 成長領域にフォーカスし、中期成長の基盤確実に向けた顧客拡大・新製品投入に取り組む。
- 研究開発はテーマを絞り込んだ開発を行い、売上高比率は25/3期4.6%から26/3期2.6%へと鈍化。

全社

(単位：百万円)

	2025/3月期 通期実績	2026/3月期 通期予想	増減額	増減率
売上高	6,516	7,006	489	7.5%
営業利益	56	136	79	141.6%
経常利益	54	130	75	138.6%
当期純利益	▲14	100	114	-
研究開発費	301	182	▲119	▲39.6%

セグメント別

(単位：百万円)

	2025/3月期 通期実績	2026/3月期 通期予想	増減額	増減率
売上高	6,516	7,006	489	7.5%
電子システム事業	3,019	3,445	425	14.1%
マイクロエレクトロニクス事業	2,068	2,152	83	4.0%
製品開発事業	1,427	1,409	▲18	▲1.3%

安定的・継続的な株主還元の考えを継続し、配当を実施する予定です。

(単位：円)

	1株当たり当期純利益および配当金	
	2025/3月期 実績	2026/3月期 予想
1株当たり当期純利益	▲3.2	22.6
中間配当金	0	0
期末配当金	15	15
年間配当金	15	15

※2025年5月13日現在において、配当予想額は、1株当たり = 15円を予定しております。

本資料で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

ご注意事項

数字の処理について

当社業績に関する記載金額は特に明記が無い限り、以下の通り処理しております。そのため内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- ・表、グラフの金額：表示単位未満を切り捨て
- ・比率：表示単位第1位未満を四捨五入

お問い合わせ先

株式会社シキノハイテック

取締役管理本部長 舩田 敏彰

e-mail：IR-contact@shikino.co.jp

TEL：0765-22-3477 FAX：0765-22-3916

ホームページ：https://www.shikino.co.jp/